

# 반도체

## 2Q24 소부장 실적 톺아보기

### 장비: 전공정은 반등 시작, 후공정은 HBM 위주 차별적 개선 지속

전공정 장비업체 전반적으로 2Q24부터는 실적 증가, 최소한 바닥을 지났다는 판단이다. 1a, 1b항 노출도가 큰 주성엔지니어링, 유진테크는 1분기 대비 매출액과 영업이익 모두 개선된 실적이 전망되며 원익IPS는 전분기 대비 적자 축소할 것으로 전망한다. 중국향 수주 증가한 피에스케이, 파크시스템스는 2분기 컨센서스 상회할 것으로 전망한다. HPSP는 2분기를 바닥으로 3분기부터 뚜렷한 실적 개선이 전망된다. 2H24에는 SK하이닉스 Wuxi 전환투자가 지속되는 외중 M16 D1b 신규 투자가 기대된다. 삼성전자 P3항 D1c항 발주 역시 기대해볼만하다. 이에 따라 전공정 장비업체는 상저하고 흐름으로 분기별 실적 개선을 기대한다. HBM으로 인한 범용 DRAM CAPA 잠식 효과를 감안할 때 2025년 전공정 신규 투자에 대한 당위성 역시 증가하고 있다.

후공정은 HBM 관련 장비 발주가 2H23부터 꾸준히 이어지고 있으며 이에 따른 차별적인 실적 성장이 전망된다. 테크윙은 컨센서스 소폭 상회하는 2분기 실적을 발표하였고 주요 고객사향 HBM용 TC본더를 납품 중인 한미반도체는 2분기 컨센서스 부합하는 실적 발표할 전망이다.

### 소재/부품: 저점 확인은 했으나 반등세는 아직

2Q24 소재/부품은 전반적으로 1분기 대비 flat한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 아직까지 세트 수요가 강하게 올라오지 않고 있어 상반기 적극적인 신규 투자를 기대하기 어려웠고, 가동률 역시 수요가 살아있는 DRAM 위주로 먼저 회복하였다. 국내 소재/부품 업체들은 대체적으로 NAND향 매출 비중이 더 크기 때문에 가동률 상승에 대한 시장 기대감과는 괴리가 발생하였다.

당사 Watch list 중에서는 애프터 부품 업체인 월텍스가 매출액 기준 +20% QoQ 성장할 것으로 전망한다.

### 결론: 2025년 선단공정 Capex 당위성은 충분

실적 반등과 하반기 이후 높아지는 선단공정 Capex 가시성을 기반으로 전공정 장비 업체를 주목할 타이밍이다. 현재 시점에서는 P4 투자 재개 움직임이 기대되는 삼성전자 밸류체인이 수주 모멘텀이 크다는 판단이다. HBM으로 인한 일반 DRAM CAPA 잠식 효과 감안 시 특히 DRAM 투자는 필수적이며 또한 HBM에서 가장 중요한 발열 대비 전력소비를 결정짓는 것은 결국 전공정 설계 역량이다. 선단공정에 대한 투자가 하반기부터 증가한다는 판단이다.

이수림 반도체  
02-709-2661  
surim.lee@ds-sec.co.kr

2024.07.19

비중확대 (유지)

## 2Q24 소부장 실적 톺아보기

### 질어지는 하반기 전공정 투자의 향기

#### 전공정 장비업체 반등 시작

전공정 장비  
2Q24부터 실적 증가  
하반기 장비 발주 지속

전공정 장비업체 전반적으로 2Q24부터는 실적 증가, 최소한 바닥을 지났다는 판단이다. 2H24에는 SK하이닉스 Wuxi 전환투자가 지속되는 와중 M16 D1b 신규 투자가 기대된다. 삼성전자 P3향 D1c향 발주 역시 기대해볼만 하다. 이에 따라 전공정 장비업체는 상저하고 흐름으로 분기별 실적 개선을 기대한다. HBM으로 인한 범용 DRAM CAPA 잠식 효과를 감안할 때 2025년 전공정 신규 투자에 대한 당위성 역시 증가하고 있다.

상반기는 선단공정  
Migration 중심

1H24 전공정은 DRAM 선단 Migration 중심으로 장비 발주가 나타나는 모습이었다. SK하이닉스는 Wuxi D1a 전환 장비 중심으로 발주되었고 삼성전자는 P3 DRAM 신규 투자를 진행한 것으로 파악한다. 이외 Micron, 중국 IDM 업체향 발주도 진행되었다. SK하이닉스향 ALD 장비를 납품하는 주성엔지니어링은 1분기 대비 개선된 실적이 전망되며 삼성전자, SK하이닉스 모두 고객사로 두고 있는 유진테크 역시 실적 성장, 원익IPS는 전분기 대비 적자 축소 할 것으로 전망한다. 중국향 수주 증가한 피에스케이, 파크시스템스는 2분기 컨센서스 상회할 것으로 전망한다. 신규로 중국 고객사 다변화가 시작되는 HPSP는 2분기를 바닥으로 3분기부터 뚜렷한 실적 개선이 전망된다

표1 메모리 3사 전공정 장비 납품 타임라인 추정 (전환투자 포함)

	DRAM	NAND
1H24	SK하이닉스 Wuxi D1a (전환) 삼성전자 Line15 D1b (전환), P3 D1a 30K (신규) Micron 일본, 대만	삼성전자 Xian V8 (전환)
2H24	SK하이닉스 M16 D1b (신규) 20K 삼성전자 P3 D1c (신규)	
1H25	SK하이닉스 M14 D1b (전환)	삼성전자 P4 Ph1 V9, V10 (신규)
2H25	SK하이닉스 M15X (신규) 삼성전자 P4 Ph3 Micron Boise	
1H26	SK하이닉스 M17	
2H26	SK하이닉스 용인 클러스터 Micron Clay	

자료: DS투자증권 리서치센터 추정

표2 공급업체별 전공정 장비 업체(국내 상장사)

	삼성전자	SK하이닉스
산화	피에스케이 원익IPS	
증착	유진테크 원익IPS 테스	주성엔지니어링 유진테크 원익IPS 테스
CMP	케이씨텍	케이씨텍
세정	피에스케이 제우스	에스티아이 제우스
PR Strip	피에스케이	피에스케이
식각		브이엠
EDS	와이씨	

자료: DS투자증권 리서치센터

표3 메모리 업체 신규 Fab 증설 계획

기업명	Fab 명	도시	국가	건설 시작	양산 시작	투자금액(USD M)	생산 제품 계획
YMTC	Fab2	Wuhan	중국	2020	2024		Memory, 3D NAND
CXMT	Fab2	Beijing	중국		2024		DRAM
Kioxia	Y7	Yokkaichi	일본	2021	2025	9,000	Memory, 3D NAND
Micron	N/A	Boise, Idaho	미국	2023	2025	15,000	Memory/DRAM
삼성전자	P4	평택	한국	2022	2025		Memory, 3D NAND
SK 하이닉스	M17	용인	한국		2025	11,000	Memory / NAND / DRAM
SK 하이닉스	M15	청주	한국	2023	2025	3,300	Memory
SK 하이닉스	M15X	청주	한국	2022	2026	11,800	Memory
삼성전자	P5 Phase1	평택	한국		2027		DRAM
CXMT	Fab3	Beijing	중국		2027		DRAM
CXMT	Fab3	Hefei	중국	2023	2028		DRAM
SK 하이닉스	용인 Cluster	용인	한국	2023	2027	88,000	Memory/DRAM
삼성전자	P5 Phase2	평택	한국	N/A	2028		Memory, 3D NAND
Micron	Fab16 A5	Taichung	대만	N/A	2029		DRAM
삼성전자	5 fabs, Mega fab	용인	한국	2023	2042	230,000	
Micron		Clay, New York	미국	2024	2026~2030		Memory/DRAM
Micron		Hiroshima	일본	2023		3,700	DRAM
SK 하이닉스	Fab3	Dalian	중국	2022			Memory, 3D NAND

자료: DS투자증권 리서치센터

표4 1Q24 글로벌 장비업체 컨퍼런스 콜 전망 요약

기업	컨콜 내 톤 관련 코멘트 정리
ASML	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 메모리 부문 매출 선단공정 전환에 힘입어 증가 예상</li> <li>- 24년 로직 부문 매출은 고객사들이 전년도 설치 용량 소화하느라 감소 예상</li> </ul>
Lam Research	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 HBM 관련 출하량 3배 이상 증가 예상</li> <li>- 24년 FinFET → GAA 전환 과정에서 GAA 출하량 10억 달러 초과 예상</li> <li>- 25년으로 접어들면서 NAND 선단공정으로 전환 시작될 것으로 예상</li> </ul>
AMAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 GAA 향 매출 25억 달러 이상 예상하며 25년에는 그 두 배 이상 증가 가능</li> <li>- 24년 HBM 관련 매출 성장 전망을 23년 대비 4배에서 6배로 상향 조정</li> </ul>
ASMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 HBM에 의해 메모리 부문 매출은 23년 저점 대비 강한 반등 예상</li> <li>- 반면 파운드리에는 GAA에 대한 초기 투자 제외하면 약세(특히 5나노, 3나노) 예상</li> <li>- 대부분의 파운드리 부문 매출은 GAA 향</li> <li>- 25년 2나노 대량 생산에 대한 고객사 목표 재확인 완료</li> </ul>
Tokyo Electron	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DDR5, HBM 수요 증가로 24년 5월부터 선단공정 DRAM 투자 회복 예상</li> <li>- 25년 DRAM에 이어 NAND, 파운드리도 본격적인 투자 회복 예상</li> <li>- 특히 NAND 매출 FY2H25부터 회복 예상 (CY 기준 4Q24~1Q25), 이는 고객과 공유한 투자 계획에 기반</li> </ul>
Kokusai Electric	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4Q24부터 중국을 제외하고 글로벌적으로 선단공정 전환에 의한 수요 회복으로 특히 DRAM과 로직 부문 매출 증가 예상</li> <li>- NAND의 경우 1Q25 말부터 회복될 것으로 예상</li> </ul>

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

### 후공정 장비는 HBM 위주 차별적 개선 지속

어드밴스드 패키징,  
수율 관리 등 HBM 향  
업체들의 차별적 성장세

후공정은 메모리 3사의 HBM 관련 장비 발주가 2H23부터 꾸준히 이어지고 있으며 이에 따른 차별적인 실적 성장이 이어질 것으로 전망된다. 내년부터 HBM4 이상으로의 세대 진화가 필연적이며 최근 애플 M5칩에 TSMC SoIC-X(3D Stack) 공정 적용 논의가 이뤄지고 있어 어드밴스드 패키징 시장의 성장은 당분간 지속될 전망이다. 또한 적층 단수가 증가하면서 수율 향상 니즈 역시 증가한다.

주요 고객사향 HBM용 TC본더를 납품 중인 한미반도체는 2분기 컨센서스 부합하는 실적 발표할 전망이다. 테크윙은 컨센서스 소폭 상회하는 2분기 실적을 발표하였고 SK하이닉스향으로 레이저 어닐링 장비를 납품하는 다이이티 역시 1분기 대비 실적 개선이 전망된다.

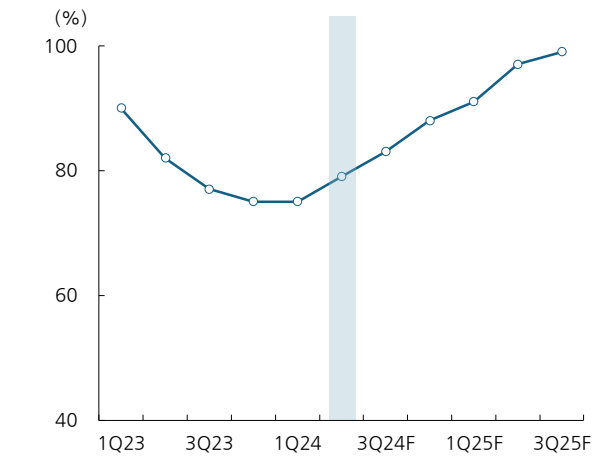
### 소재/부품: Q가 아닌 P 드라이브 사이클, 저점 확인은 했으나 반등세는 아직

NAND 비중이 높은  
국내 소재/부품까지는  
실적 온기가 아직

2Q24 소재/부품은 전반적으로 1분기 대비 flat한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 소재/부품은 통상적으로 CAPA 증설 이후 가동률 상승에 따라 실적이 증가한다. 특히 비포 마켓의 경우 신규 납품 장비에 탑재되기 때문에 전공정 장비 신규 납품과 동행하는 편이다.

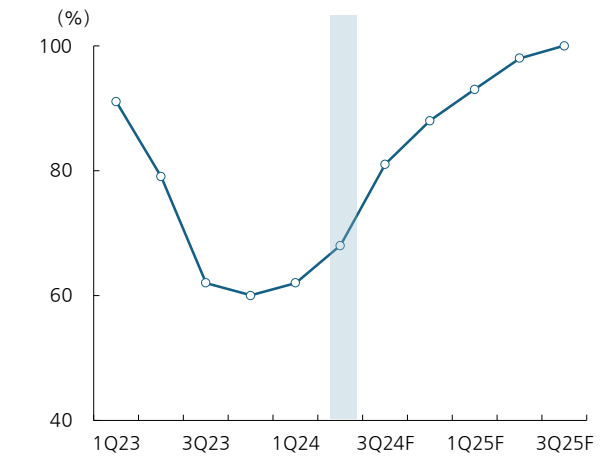
아직까지 세트 수요가 강하게 올라오지 않고 있어 메모리 업체들은 HBM을 제외한 일반 메모리 공급 증가에 대해서는 신중한 태도를 유지하고 있다. 이에 따라 상반기 적극적인 신규 투자를 기대하기 어려웠고, 가동률 역시 수요가 살아있는 DRAM 위주로 먼저 회복하였다. 국내 소재/부품 업체들은 대체적으로 NAND향 매출 비중이 더 크기 때문에 가동률 상승에 대한 시장 기대감과는 괴리가 발생하였다. 당사 Watch list 중에서는 애프터 부품 업체인 월텍스가 매출액 기준 +20% QoQ 성장할 것으로 전망한다.

그림1 DRAM 가동률 추이 및 전망



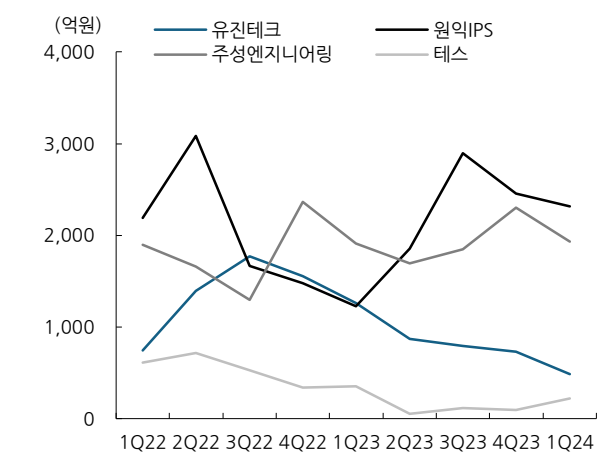
자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

그림2 NAND 가동률 추이 및 전망



자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

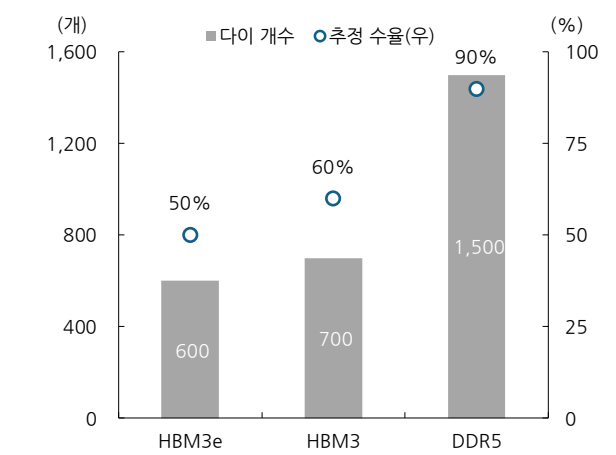
그림3 전공정 장비업체 분기별 수주잔고 추이



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

주) 원익IPS, 테스의 경우 반도체/디스플레이 등이 합산된 값

그림4 웨이퍼 1장 당 얻을 수 있는 다이 개수와 수율 비교



자료: DS투자증권 리서치센터

표5 반도체 장비업체 분기 실적 컨센서스

(억원)		1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24E	3Q24E	4Q24E	당사 의견	QoQ	YoY
원익 PS	매출액	1,504	1,346	1,799	2,254	1,138	1,485	2,133	2,697		30.5	10.3
	영업이익	(107)	(182)	(11)	121	(267)	(89)	127	319		적지	-51.4
	당기순이익	(67)	(71)	40	(38)	(225)	(24)	209	174		적지	-66.5
유진테크	매출액	775	781	503	706	684	714	872	1,038		4.4	-8.5
	영업이익	97	85	7	53	40	87	133	132	컨센 부합	119.1	1.9
	당기순이익	108	82	18	46	64						
HPSP	매출액	588	479	419	305	378	316	478	631		-16.4	-34.1
	영업이익	349	266	216	121	200	156	263	322	소폭 하회	-21.7	-41.2
	당기순이익	311	224	205	64	213	139	225	245		-35.0	-38.1
피에스케이	매출액	837	655	940	1,087	777	914	1,095	1,201		17.5	39.4
	영업이익	113	15	255	159	213	173	260	219	컨센 상회	-19.2	1,072.7
	당기순이익	110	25	200	190	206	145	214	100		-29.8	472.7
주성엔지니어링	매출액	687	317	861	983	566	1,013	1,225	1,239		79.1	220.0
	영업이익	116	(87)	62	199	70	266	360	330	컨센 부합	277.8	흑전
	당기순이익	104	(74)	40	270	161	218	277	209		35.5	흑전
이오테크닉스	매출액	839	869	740	717	728	852	1,039	1,138		17.0	-1.9
	영업이익	96	109	30	48	55	104	186	232	컨센 하회	87.9	-4.7
	당기순이익	135	126	79	24	105	84	157	213		-19.8	-33.2
한미반도체	매출액	265	491	312	522	773	1,266	1,780	2,028		63.7	158.0
	영업이익	21	112	29	184	287	495	712	842	OP 부합 NP 하회	72.5	343.1
	당기순이익	1,332	340	147	854	696	397	571	646		-43.0	16.8
파크시스템스	매출액	275	394	324	455	257	379	458	567		47.6	-4.0
	영업이익	22	101	55	98	5	89	127	158	컨센 상회	1,642.4	-12.1
	당기순이익	26	76	63	80	27	76	135	145		176.9	-1.0
넥스틴	매출액	185	360	144	190	342	146	230	367		-57.4	-59.6
	영업이익	84	166	53	59	189	48	98	160		-74.6	-71.1
	당기순이익	74	135	48	53	147	46	61	139		-68.7	-65.9
오로스테크놀로지	매출액	69	71	127	188	38	100	175	240		162.3	41.7
	영업이익	(21)	(28)	28	45	(60)	10	40	65		흑전	흑전
	당기순이익	(19)	(22)	33	41	(53)	20	20	40		-137.4	-190.3
테크윙* (2Q24P)	매출액	286	395	243	412	403	508	580	1,330		25.9	28.6
	영업이익	4	24	(27)	30	56	72	90	400	소폭 상회 실적 발표	29.2	196.2
	당기순이익	(72)	(10)	(116)	87	(82)		45	315			
와이씨	매출액	678	775	547	551	340	410	700	1,420		20.8	-47.1
	영업이익	25	(1)	5	56	1	50	80	240	컨센 하회	9,334	-8,036
	당기순이익	48	28	7	45	13	50	90	230		294.6	79.1
디아이	매출액	392	645	577	531	347	507	782	818		46.0	-21.4
	영업이익	9	56	26	(29)	(18)	40	41	33	컨센 하회	-317.7	-28.1
	당기순이익	5	39	3	(27)	(13)	30	30	30		-330.6	-22.3
디아이티	매출액	241	167	308	354	202	332	230	264		64.4	99.2
	영업이익	(15)	(9)	52	59	33	71	50	42	컨센 부합	112.1	-867.6
	당기순이익	3	4	62	63	47						
피에스케이홀딩스	매출액	149	254	149	395	381	392	464	514		3.0	54.2
	영업이익	35	85	9	140	154	156	182	187	컨센 하회	1.4	83.0
	당기순이익	87	57	77	206	190	180	232	244		-5.1	217.6

자료: QuantiWise, DS투자증권 리서치센터

표6 반도체 부품업체 분기 실적 컨센서스

(억원)		1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24E	3Q24E	4Q24E	당사 의견	QoQ	YoY
리노공업	매출액	491	751	734	580	549	758	884	700	컨센 하회	38.2	0.9
	영업이익	173	336	333	302	233	334	423	302		43.4	-0.4
	당기순이익	157	386	292	274	206	305	384	282		47.9	-21.1
티씨케이	매출액	636	474	537	619	590	676	741	789		14.5	42.4
	영업이익	221	130	149	167	174	218	256	295		25.2	67.8
	당기순이익	170	149	172	122	156	195	225	253		25.1	31.0
하나머트리얼즈	매출액	685	652	531	469	577	652	714	787	컨센 하회	12.8	-0.0
	영업이익	157	129	76	50	66	111	167	208		69.1	-14.2
	당기순이익	138	105	64	36	55	71	122	171		30.2	-32.5
원익 QnC	매출액	2,219	2,027	1,791	2,022	2,164	2,206	2,363	2,525		1.9	8.8
	영업이익	332	280	133	85	325	340	382	272		4.5	21.5
	당기순이익	219	214	6	71	226						
ISC	매출액	464	360	329	249	351	505	726	710		44.0	40.4
	영업이익	98	65	(80)	25	86	161	220	194		88.4	148.8
	당기순이익	111	50	(44)	19	158	157	225	172		-1.0	215.1
티에스이	매출액	446	573	769	703	582	681	882	746		17.0	18.8
	영업이익	(66)	(35)	68	9	(31)	12	103	76		흑전	흑전
	당기순이익	(41)	(40)	71	(11)	2	0	0	0			
코미코	매출액	631	628	913	900	1,180	1,244	1,290	1,296		5.4	98.0
	영업이익	68	65	116	82	278	280	285	267		0.7	332.5
	당기순이익	46	77	96	235	200						
월덱스	매출액	787	806	681	607	664				QoQ/YoY 증익 전망		
	영업이익	178	197	175	99	144						
	당기순이익	161	160	158	59	150						

자료: QuantiWise, DS투자증권 리서치센터

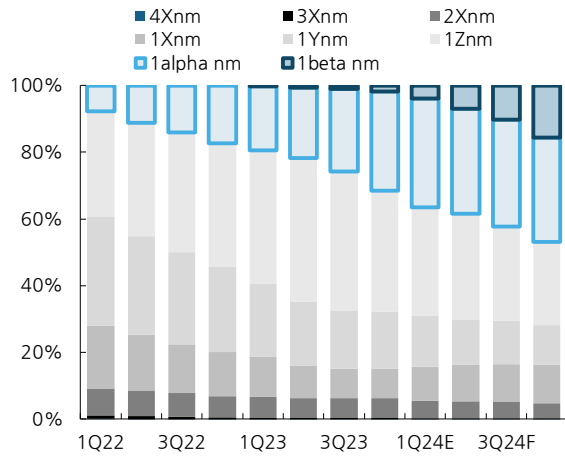
표7 반도체 소재업체 분기 실적 컨센서스

(억원)		1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24E	3Q24E	4Q24E	당사 의견	QoQ	YoY
한솔케미칼	매출액	1,973	1,947	1,883	1,915	1,979	2,077	2,161	2,205	컨센 부합	5.0	6.7
	영업이익	349	326	356	210	163	145	202	70		-10.9	-55.5
	당기순이익	291	306	303	186	317	331	380	215		4.3	8.0
솔브레인	매출액	2,430	2,187	1,874	1,950	2,107	2,194	2,416	2,580	컨센 부합	4.1	0.3
	영업이익	491	331	286	228	460	408	476	519		-11.5	23.3
	당기순이익	456	331	285	237	462	368	406	270		-20.4	10.9
이엔에프 테크놀로지	매출액	1,419	1,384	1,420	1,525	1,432						
	영업이익	52	45	104	46	75						
	당기순이익	46	(33)	55	(301)	51						
원익머트리얼즈	매출액	1,329	912	755	921	753	800	962	1,140		6.3	-12.2
	영업이익	87	50	41	69	114	134	157	198		17.7	167.2
	당기순이익	88	44	43	(37)	92	108	130	169		17.2	143.0

자료: QuantiWise, DS투자증권 리서치센터

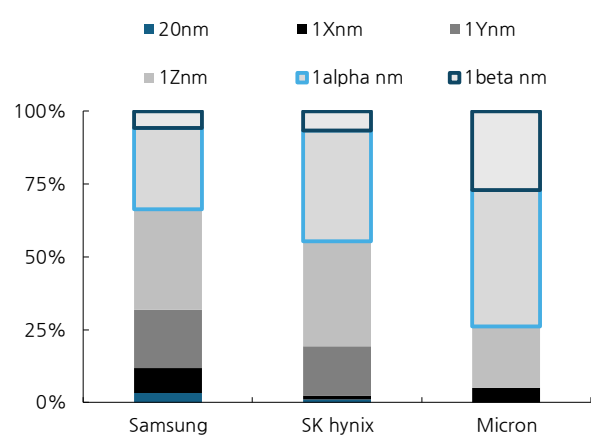


그림5 공정별 DRAM Bit 점유율



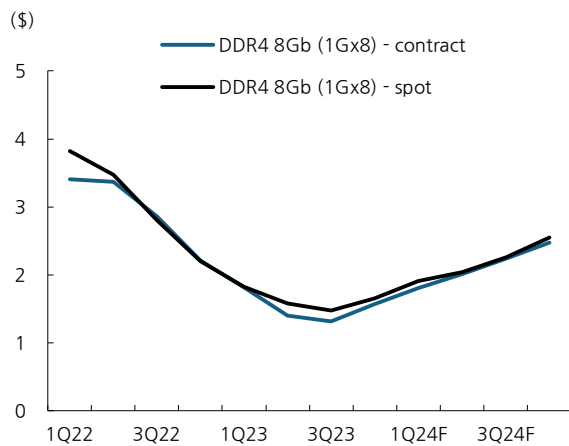
자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

그림6 공급업체별 2024년 DRAM 공정 비중



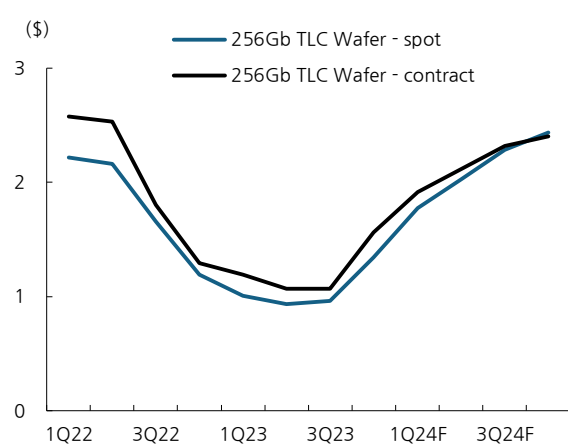
자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

그림7 DRAM Spot/Contract Price 추이 및 전망



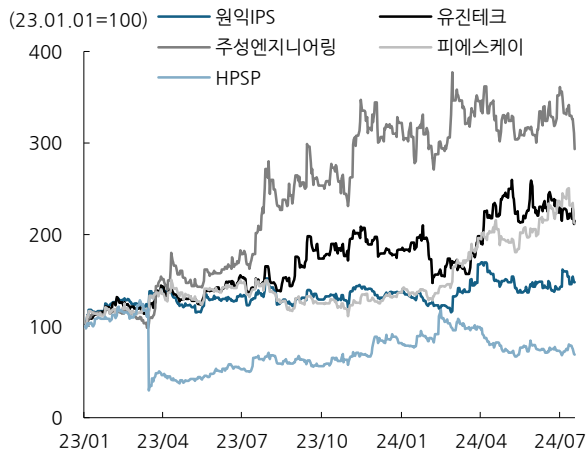
자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

그림8 NAND Spot/Contract Price 추이 및 전망



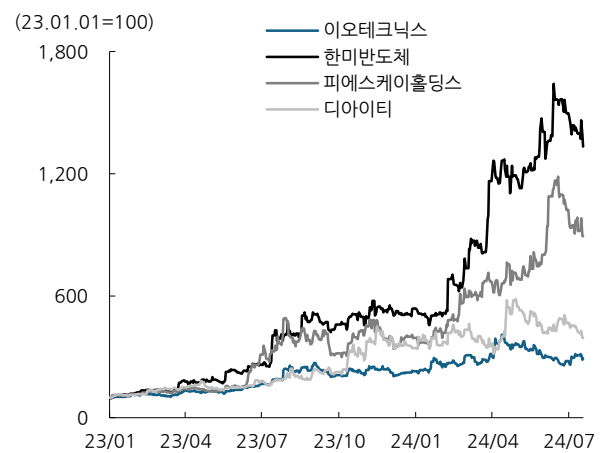
자료: 업계 자료, DS투자증권 리서치센터

그림9 반도체 전공정 장비업체 주가 추이



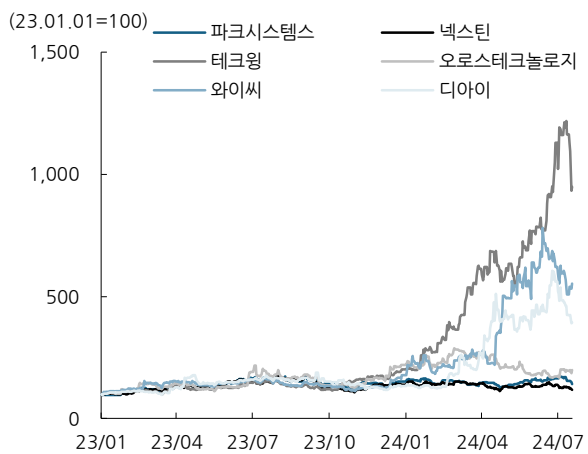
자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

그림10 반도체 후공정 장비업체 주가 추이



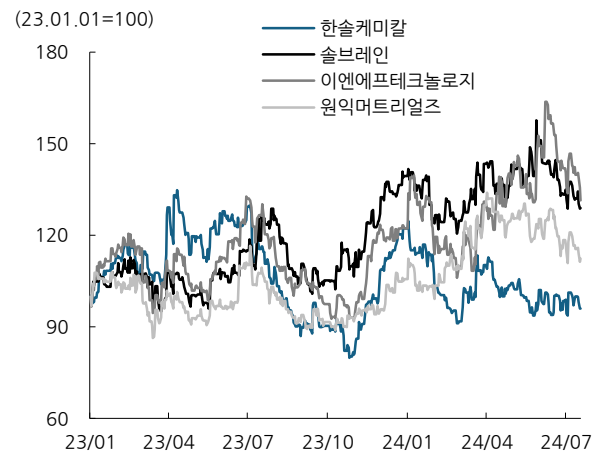
자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

그림11 반도체 검사/계측장비업체 주가 추이



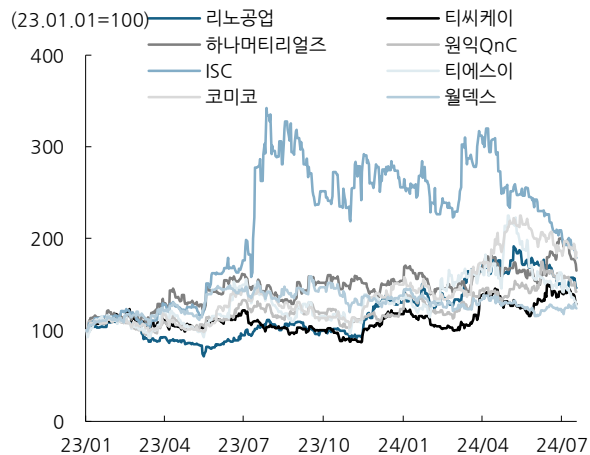
자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

그림12 반도체 소재업체 주가 추이



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

그림13 반도체 부품업체 주가 추이



자료: Quantwise, DS투자증권 리서치센터

---

**Compliance Notice**

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
  - 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
  - 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
  - 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.
-